

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	<p><u>2020年11月3日</u></p> <p>Cathay Life Insurance Co., Ltd.、CI Investments、FIL Investment Management (Hong Kong) Limited、Fountain Cap Research Institution、T Rowe Price International (Hong Kong)、Taikang Asset Management Co Ltd、Aberdeen Standard Investments、Artisan Partners (Global Equity)、Cinctive Capital Management、Eastspring Investments (Singapore)、Fiera Capital、GAM、Samsung Asset Management Co. Ltd、Swedbank Robur AB、Sylebra Capital Management、UOB Asset Management Ltd</p> <p><u>2020年11月5日</u></p> <p>信达证券、金鹰基金、基研投资本、长城基金、泰康资产管理、中邮基金、泓德基金、新华基金、中荷人寿、汇丰晋信、观富资产、摩根士丹利华鑫基金、泰信基金、久泰基金、大合投资</p> <p><u>2020年11月6日</u></p> <p>国信证券、国泰投信、复华投信、富兰克林华美投信</p> <p><u>2020年11月11日</u></p>

	<p>申万宏源、永赢基金、兴银基金、中天国富证券、万吨资产、国泰君安、华安证券、汇丰晋信、域秀资本、沃泷资本、江控创富基金、上海人寿、创芮企业管理、中加基金、中国太平</p> <p><u>2020年11月13日</u></p> <p>汇丰前海、东方证券资管</p> <p><u>2020年11月18日</u></p> <p>中信建投、中金公司、凯丰投资、源乘投资、盈峰资本、诚盛投资、毕盛投资、泓德基金、中国平安、磐泽资产、混沌投资、新华资产、沅京资本、中信证券、红土创新基金、槐南资管、三江资本、中信产业基金、博时基金、淡水泉投资、涌容资产、盘京投资、璟熔投资</p> <p><u>2020年11月19日</u></p> <p>中再资产、嘉远资本、正圆投资、东方阿尔法基金、华夏理财</p> <p><u>2020年11月24日</u></p> <p>瑞士信贷、国海富兰克林、易方达、Inforesight Investment、Spring Gate Capita、Fullerton、Ariose Capital、Millennium Investment Management、Samsung Asset Management</p> <p><u>2020年11月25日</u></p> <p>财通证券</p>
时间	2020年11月3日，2020年11月5日，2020年11月6日，2020年11月11日，2020年11月18日，2020年11月19日，2020年11月24日，2020年11月25日
地点	线上会议（2020年11月3日，2020年11月5日，2020年11月6日） 中国金融信息中心（2020年11月11日，2020年11月24日） 公司会议室（2020年11月13日，2020年11月25日）

	<p>深圳市福田区香格里拉（2020年11月18日）</p> <p>海口市万丽酒店（2020年11月19日）</p>
<p>公司接待人员姓名</p>	<p>公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）</p> <p>公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	
<p>公司介绍</p>	<p>芯原股份是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器 IP、神经网络处理器 IP、视频处理器 IP、数字信号处理器 IP 和图像信号处理器 IP 五类处理器 IP、1,400 多个数模混合 IP 和射频 IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括 IDM、芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司。</p> <p>芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，并已开始进行 5nm FinFET 芯片的设计研发和新一代 FD-SOI 工艺节点芯片的设计预研。此外，根据 IPnest 统计，芯原是 2019 年中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体 IP 授权服务提供商。</p> <p>在全球新冠疫情爆发的大背景下，公司 2020 年前三季度业绩稳定增长，2020 年 1-9 月公司实现营业收入 10.61 亿元，同比增长 11.60%，主要得益于知识产权授权业务和芯片量产业务的增长，同比增长率分别为 33.67% 及 43.89%，其中 2020 年第三季度公司营业收入为 3.73 亿元，同比增长 8.89%。</p>

<p>交流问答</p>	<p>问题 1： 请问公司预计未来行业内晶圆厂产能紧张的局面是否会缓解？如果不能，是否会对公司第四季度乃至明年的业务造成影响？</p> <p>回复： 考虑到目前行业内的供需情况，公司预计行业内晶圆厂产能紧张的局面在短期内较难改变。因此，公司已经做出了积极应对，和多家晶圆厂保持良好的合作关系，按照客户的需求提前采购了部分订单的原材料并预定了产能，希望可以尽可能降低产能紧张带来的风险，满足客户正常芯片生产的需要。</p> <p>问题 2： 请问公司的 IP 授权业务中，已覆盖 IP 的市场份额是多少，有没有份额提升的空间？</p> <p>回复： 公司目前半导体 IP 种类的齐备程度高，在全球前七名的半导体 IP 授权供应商中也有较强竞争力。根据 IPnest 统计，2019 年发行人半导体 IP 全球市场占有率从 1.5%提升到了 1.8%，同比增长 20%。其中，GPU IP（含 ISP）市场占有率排名全球前三，2019 年全球市场占有率约为 11.8%；DSP IP 的市场占有率排名世界前三，2019 年全球市场占有率约为 8.9%。芯原股份的 VPU IP 和 NPU IP 也处于全球领先地位。在较为齐备的 IP 储备下，同时公司致力于完善和提高平台化芯片设计服务能力，实现两块业务协同发展。</p> <p>问题 3： 可否简要介绍下公司的合营公司芯思原的业务情况如何？在财务方面有没有做合并报表处理？</p> <p>回复： 芯思原是芯原股份和新思科技及其他投资方在 2018 年出资设立的合营公司，芯原股份占比为 56%。芯思原主营业务为技术研发及半导体 IP 授权服务，其主要针对 40nm 以上工艺节点 IP 的研发与授权。在技术研发方面，芯思原着重于通过研发将新思科技转授权的半导</p>

体 IP 移植到国内的半导体生产工艺线上，在扩充自身半导体 IP 储备的同时，也可以向国内芯片代工厂引进全球领先的半导体 IP。在半导体 IP 授权方面，芯思原主要 IP 涵盖高速接口数模混合 IP，如 DDR、MIPI、PCIE、SATA、USB、HDMI 等。根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》应用指南，公司未将其纳入合并报表范围。

问题 4：请问公司是如何确保研发出的 IP 符合客户需要？

回复：在 IP 研发上，公司选取具有复用性、关键性、先导性的 IP 底层技术进行预研或加强研发，自有 IP 的储备和增强可以帮助公司更加有选择性地加入先进技术领域和优质客户群体。同时，根据客户对于 IP 的反馈以及行业发展趋势，公司也会根据需求开展相关的发工作，从而持续丰富公司的 IP 资源库。

问题 5：请问公司的 IP 是否都是一次性授权？

回复：公司的 IP 授权业务定价主要与授权 IP 种类、授权次数、授权期限、市场竞争程度等有关。其中，授权次数是指客户可以使用该 IP 设计集成电路产品的个数；授权期限是指客户使用该 IP 设计集成电路产品的最晚使用期限，规定授权期限一般是为了促使客户尽快使用 IP。IP 授权服务后续产生的特许权使用费是长期的。在客户的芯片设计阶段，公司直接向客户交付半导体 IP，并获取知识产权授权使用费收入，待客户使用此 IP 完成芯片设计并量产后，公司按照合同约定，根据客户芯片的销售情况，按照量产芯片销售颗数获取特许权使用费收入。

问题 6：公司的射频 IP 在 2019 年有很大的增长，请问增长点在哪？

回复：公司的射频 IP 主要包括低功耗蓝牙技术和窄带物联网技术，随着公司射频 IP 相关技术不断积累和完善，其 2019 年收入有所增长。

尤其是在 FD-SOI 领域，芯原开发了面向物联网芯片的超低功耗 IP 平台，积累了丰富的项目经验及大量优质客户，助力物联网、可穿戴、射频芯片等相关项目的推进，在射频 IP 方面带来收入增长。

问题 7：请公司介绍下项目推进的内部管理方式和机制。

回复：公司采用一站式全流程管理模式，为客户提供从芯片定义、IP 选型及工艺评估，到芯片设计、验证、实现、样片流片、小生产测试，直至大规模量产的全流程服务。在芯片设计阶段，公司会指定项目管理经理根据项目内容负责与客户沟通、质量监督，设计进度把控、资源调度，每周和客户更新项目进展；在芯片设计完成进入小批量生产测试阶段，项目管理经理和生产管理经理协同管理，负责委外制造，封装和测试，优化项目的生产流程以提高芯片制造的良率及稳定性；进入量产阶段，主要由生产管理经理对项目进行长期跟踪管理，并根据客户反馈和内外部需求，协同采购部门继续对生产流程的每一个环节进行优化。

问题 8：请问公司预计未来 IC 业务的增长趋势是怎样的？

回复：2020 年上半年，公司 IC 设计方面的营收一定程度上受到了战略性研发项目的影响。但随着项目不断推进，陆续进入研发人员的释放期，进一步促进公司芯片设计业务收入的成长。在 2020 年第三季度，设计业务收入已经有所回升，预计在未来会恢复至往年的水平甚至有所增加。

问题 9：请问公司的项目从芯片设计到量产阶段的比例有多大？

回复：公司的一站式芯片定制服务主要面向消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛应用市场，包括芯片设计

业务和芯片量产业务。据统计，公司的绝大部分项目在完成芯片设计后都能进入量产阶段，量产的数量会受到市场容量的影响。有少数客户没有成功量产，可能是受到市场环境变化的影响。公司在与客户的洽谈过程中也会对客户和市场情况进行调查及判断，尽量选择有能力保障项目进入量产阶段的优质客户进行合作。

问题 10： 请问公司目前募投资金的使用方向有哪些？

回复：公司科创板 IPO 募集资金主要投入在智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目、智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目、智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台、智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目及研发中心升级项目等五个募投项目。目前，公司募投项目正在有序开展，关于募集资金和超募资金的使用情况公司会根据相关法律法规履行信息披露义务。

问题 11： 听说公司董事长兼总经理戴伟民博士十分注重团队建设，可否详细介绍一下？

回复：公司董事长兼总经理戴伟民博士坚信芯原股份最关键的资源是人才，公司至今拥有一千多名员工，不仅是应届毕业生，每一个员工入职都会经过戴总的亲自面试。在企业管理上，公司奉行 Fair、Care、Share 和 Cheer，用人文精神和人文关怀引导公司发展，公司良好的企业文化也有助于团队的稳定性，离职率处于行业较低水平。

问题 12： 请问公司未来的研发费用大概会保持在什么水平？

回复：多年来持续的高额研发投入是芯原尚未实现持续盈利的重要原因。未来，公司仍将保持研发层面的投入强度，以进一步提高公司

半导体 IP 储备和一站式芯片定制业务的竞争优势，并根据发展战略进行研发布局以实现未来跨越式发展，使公司成为具有第一梯队芯片设计能力的芯片设计技术研发、授权和服务平台。随着公司一站式芯片定制业务中可复用解决方案趋于成熟，半导体 IP 储备渐形成规模，技术储备基本成型以及独特商业模式带来的规模化效应不断显现，公司未来收入增长速度将不断提高。相较于高速增长的营业收入，公司研发费用总额的增长则会随着公司技术研发的基本完善而有所放缓，研发费用率会出现合理回落。

问题 13：请问公司预计员工数量的增长速度大概在什么水平？

回复：公司坚信最关键的资源就是人才，并且十分注重团队建设。未来公司会不断扩充团队，但增长的速率不会特别快，这是因为虽然芯片设计业务和人员数量成正相关关系，但量产业务的规模化效应使该部分业务与人员数量关系不大，因此公司的员工数量会保持稳步增长。

问题 14：如果公司认为某些产品比较有前景，会自己推出产品吗？

回复：不会，芯原坚持的商业模式是给客户id提供一站式芯片定制服务，而不是销售自有产品，这种经营模式使得公司集中力量于自身最为擅长的技术授权和研发平台输出，市场风险和库存风险压力较小，也不会让我们和下游的客户发生竞争。

问题 15：请问公司财务报表中芯片定制业务收入分为设计业务和量产业务，分别指的是什么？

回复：这实际上是公司的一站式芯片定制服务，在收入上按环节

分成设计业务收入和量产业务收入。两个业务环节的收入确认方式不同，所以分成了两个部分。芯片设计业务主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，即根据客户对芯片在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和 IP 选型，通过设计、实现及验证，逐步转化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产工程晶圆，封装厂及测试厂进行工程样片封装测试，从而完成芯片样片生产，最终将经过公司技术人员验证过的样片交付给客户的全部过程。

问题 16：现在行业内很多 IP 公司开始做 EDA，请问芯原是否有这样的计划？

回复：现在很多 EDA 公司都开始发展 IP 业务，由此可见目前的 EDA 市场已经接近饱和，有一定局限性，国内企业发展 EDA 需要立足于新的商业模式。而芯原的两部分主营业务是没有边界的，因此目前公司还是专注于一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务。

问题 17：请分享一下芯原收购成功背后的原因。

回复：一方面是因为公司技术在行业中有较强竞争力，根据 IPnest 统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体 IP 供应商。芯原在全球前七名半导体 IP 授权供应商中，IP 种类的齐备程度也具有较强竞争力。

另一方面，芯原多年来形成的企业文化也起到了一定的作用。公司董事长兼总经理戴伟民博士坚信要取得合并的成功，就要与员工为核心。在企业管理上，公司奉行 Fair、Care、Share 和 Cheer，用人文精神和人文关怀引导公司发展，公司良好的企业文化也有助于团队的稳定性，离职率处于行业较低水平。

问题 18：请问哪几个行业对公司的收入驱动比较大？

回复：公司主营业务的应用领域非常广泛，包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等。从主营业务收入的角度来看，消费电子、物联网和数据中心占比较高，在 2019 年度分别占主营业务收入的 38.08%、23.95%和 19.53%。此外，汽车电子和工业领域方面的应用都有很大的增长潜力。

问题 19：请问客户选择芯原是看到了公司的哪些优势？芯原和客户合作期限大概是多久？

回复：芯原拥有多种成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片设计能力、丰富的芯片设计经验以及深厚的半导体 IP 储备，能够帮助客户高效率、高质量、低成本、低风险地完成芯片的设计实现和量产出货。公司和客户的合作是以项目为单位，而不是按照年份。

问题 20：请介绍一下公司选择的轻设计模式。

回复：芯原目前采用的 SiPaaS 模式符合集成电路产业轻设计模式的发展趋势，在轻设计模式下，芯片设计公司可以专注于芯片定义、芯片架构、软件/算法，以及市场营销等，将芯片前端和后端设计，量产管理等全部或部分外包给设计服务公司，以及更多地采用半导体 IP，减少运营支出，实现轻量化运营。